

# Leiterplatten Serien

## Leiterplatten Fertigung Beispiele unsere Vielseitigkeit

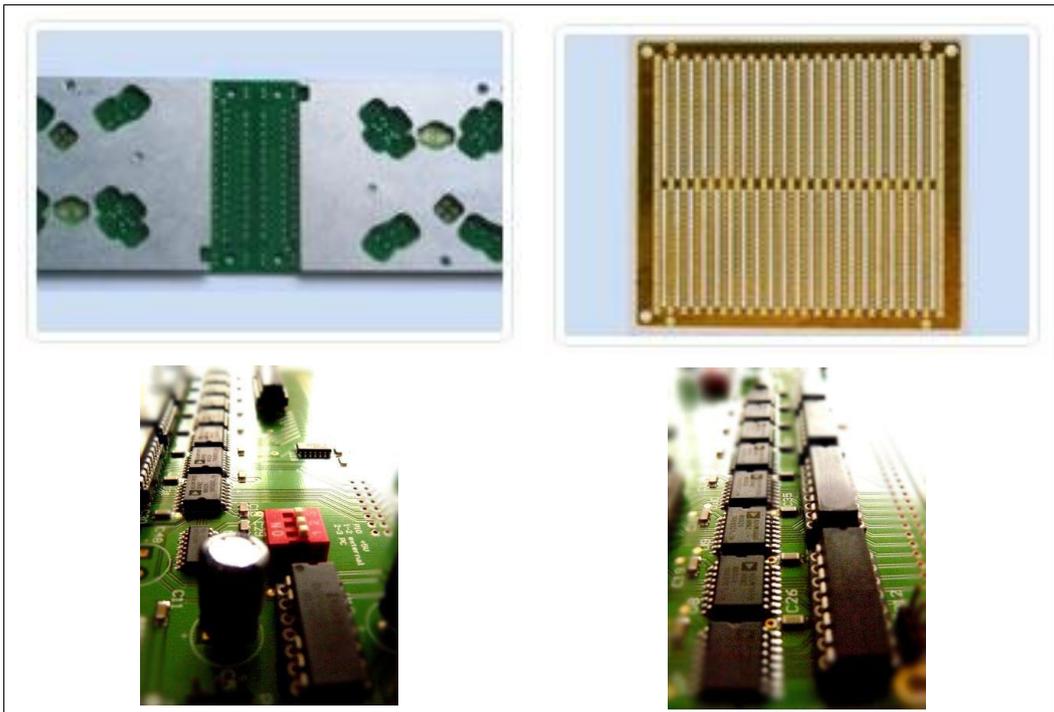
### Unsere Leiterplatten - Produktpalette erstreckt sich von:

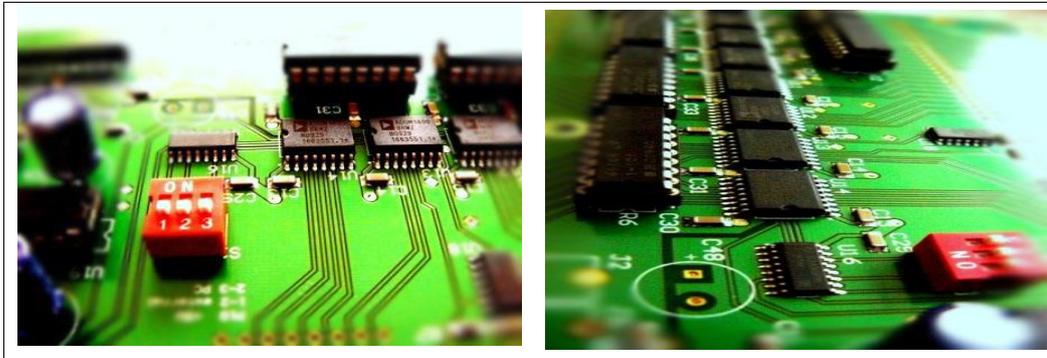
- Entwicklungen über Layouts
- Kabelkonfektion im Kleinserienbereich
- Komplettengeräten im Kleinserienbereich
- COB - Bonden
- Aluminium- Leiterplatten
- Micro - Leiterplatten
- HDI - Leiterplatten
- Heatsink - Leiterplatten
- Flex- und Starrflex - Leiterplatten
- Leiterplatten im Pool
- Kleinserien - Leiterplatten
- bestückten Kleinserien
- bestückten Großserien
- bis zu unbestückten Großserien-Leiterplatten bis 20 Lagen aus China

## Technische Möglichkeiten der Leiterplatten - Herstellung unseres Chinesischen Partners

- Dickkupfer mit 3oz Basis Kupfer für starre Leiterplatten.
- Rogers 3004
- Bergquist Basismaterial für Aluminium Platten

Tech Data	Capacity
Layers (Mass production)	2 - 20 layers
Max Board Size	610mm x 610mm (24" x 24")
Finishing Board Thickness	16mil - 39mil
Min Line Width	4mil
Min Hole Size	12mil
Hole position deviation	2mil
PTH Hole Dia. Tolerance	3mil
Non PTH Dia. Tolerance	2mil
Route Outline Tolerance	±4mil
Punch Outline Tolerance	±8mil
Min S/M Pitch	4mil
Twist & Bent	≤1.5%
Peel Strength	1.4N/mm
Solder Mask Abrasion	>4H
Thermal Stress	288°C 20sec
Current Breakdown	10A





**Das war nur eine kurze Information unserer Möglichkeiten**

Copyright © 2009 - B&D electronic print Limited & Co. KG  
61348 Bad Homburg, Jacobistrasse 38  
Telefon: +49 (0) 6172 92 13 570 + 571  
Telefax: +49 (0) 6172 92 13 573  
E-Mail: [anfrage@electronicprint.eu](mailto:anfrage@electronicprint.eu)  
[Impressum](#) - [AGB's](#) - [Datenschutz](#)  
Alle Rechte vorbehalten